



CHAPES ET ISOLANTS

FOAMGLAS® FLOOR BOARD F



Description

Domaines d'application:

Isolation des sols avec exigences particulièrement hautes de résistance à la compression

Caractéristiques techniques

Densité	~165 kg/m3
Epaisseur	40.00 mm
Conductivité thermique	0,050 W/mK
Longueur	1.20 m
Résistance à la compression	≥ 1600 kPa
Largeur	0.60 m

^{*} autres épaisseurs disponibles sur demande

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Fiche produit

Déclaration de performances

Fiche de données de sécurité

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier